

Edição Número 239 de 14/12/2006
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL N o 243, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no § 2 o do art. 4 o da Lei n o 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1 o do art. 2 o , e nos artigos 16 e 18 do Decreto n o 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC n o 52000.007092/2001-54, de 14 de janeiro de 2001, R E S O L V E M:

Art. 1 o O Processo Produtivo Básico para o produto CARTÃO INTELIGENTE (smart card), industrializado no País, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT n o 283, de 6 de setembro de 2005, passa a ser o seguinte:

I - CARTÕES INTELIGENTES COM CONTATO:

- a) fresamento da cavidade do cartão plástico;
- b) separação e preparação dos módulos de microchips;
- c) aplicação do adesivo na cavidade do cartão; e
- d) fixação do módulo de microchip no cartão.

II - CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO:

- a) fresagem da folha de PVC (formação do calço);
- b) impressão das folhas de PVC, quando aplicável;
- c) montagem do microchip na antena; e
- d) fusão (laminação) do conjunto calço, antena, folhas de PVC e folha de cristal de PVC.

§ 1 o Todas as etapas do Processo Produtivo Básico acima descritas deverão ser realizadas no País.

§ 2 o As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas neste artigo poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto as etapas descritas nas alíneas "c" e "d" do inciso I e "d" do inciso II deste artigo.

§ 3 o Os cartões plásticos mencionados no inciso I deverão ser produzidos no País a partir da fusão das folhas plásticas.

Art. 2 o Os circuitos integrados monolíticos ou microchips mencionados nos incisos I e II do art. 1 o deverão atender, a partir de 1 o de janeiro de 2009, ao seguinte Processo Produtivo Básico, para um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) da produção do ano calendário.

I - montagem de pastilha semicondutora, não encapsulada;

II - encapsulamento da pastilha montada;

III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e

IV - marcação (identificação).

§ 1 o Os circuitos integrados monolíticos ou microchips de que trata este artigo poderão ser adquiridos de terceiros, desde que cumpra o Processo Produtivo Básico estabelecido neste artigo.

§ 2 o A obrigatoriedade estabelecida no caput deste artigo deixa de ser exigida no período correspondente a 1 o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008.

§ 3 o Que haja compromisso das empresas na promoção de processo de desenvolvimento de fornecedores para o cumprimento das etapas estabelecidas no caput deste artigo, por meio da apresentação relatórios semestrais das ações efetivamente, realizadas na localização dos potenciais fornecedores para o encapsulamento dos chips, que deverão ser apresentados 6 (seis) meses a contar, a partir, da data de publicação da Portaria, sendo que a implementação das ações não deverão ultrapassar a 6 (seis) meses da data do termino da dispensa.

Art. 3 o Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 4 o Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n o 283, de 6 de setembro de 2005.

Art. 5 o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO FURLAN

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SERGIO MACHADO REZENDE

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia